

华通电脑（重庆）有限公司
年产 600 万平方英尺高密度互连印制电路板(HDI)项目
竣工环境保护验收公示说明

根据《国务院关于修改《建设项目竣工环境保护管理条例》的决定》（中华人民共和国国务院令 第 682 号）以及环保部《关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》（国环规环评[2017]4号）的有关规定，现将《华通电脑（重庆）有限公司年产 600 万平方英尺高密度互连印制电路板(HDI)项目竣工环境保护验收监测报告》及相关资料公示如下：

项目名称：年产 600 万平方英尺高密度互连印制电路板(HDI)项目

建设单位：华通电脑（重庆）有限公司

建设地点：重庆市涪陵区盘龙路 21 号

建设内容：建设年产 600 万平方英尺高密度互连印制电路板生产线，主要包括线路制作、显影、蚀刻、去膜、棕化、钻孔、镀铜、表面处理（显影、化学镍、浸金等）等工序，配套建设公用工程、辅助工程、环保工程、储运工程及办公生活设施。

公示内容：竣工环境保护验收监测报告、专家意见等（详见附件）

公示时间：2020 年 3 月 12 日至 2019 年 4 月 9 日

公示期间：对上述公示内容如有异议，请以书面形式反馈，个人须署真实姓名，单位须加盖公章

联系人：汪老师

联系电话：023-72121111-6082